

## 日月光一〇一年度第一季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 101 年 4 月 27 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇一年度第一季獲利報告，本公司一〇一年第一季之合併營業收入較一〇〇年第四季衰退 7%，較一〇〇年同期衰退 6%，為新台幣 43,101 百萬元。茲將日月光一〇一年度第一季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

### 簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

| 項 目            | 101 年度<br>第一季 | 100 年度<br>第四季 | 100 年度<br>第一季 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 營業收入           | 43,101        | 46,390        | 46,005        |
| 營業毛利           | 7,188         | 8,475         | 8,658         |
| 營業淨利(淨損)       | 2,846         | 3,501         | 4,387         |
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 2,583         | 2,952         | 5,096         |
| 所得稅利益(費用)      | (465)         | (340)         | (963)         |
| 少數股權純損(益)      | (62)          | 27            | (159)         |
| 本期淨利(淨損)       | 2,056         | 2,639         | 3,974         |
| 稀釋每股盈餘(元)      | 0.31          | 0.40          | 0.58          |

### 簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

| 項 目            | 101 年度<br>第一季 | 100 年度<br>第四季 | 100 年度<br>第一季 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 營業收入           | 29,236        | 31,908        | 30,879        |
| 營業毛利           | 5,656         | 6,790         | 7,095         |
| 營業淨利(淨損)       | 2,424         | 3,156         | 3,970         |
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 2,423         | 2,937         | 4,774         |
| 所得稅利益(費用)      | (356)         | (329)         | (645)         |
| 少數股權純損(益)      | (11)          | 31            | (155)         |
| 本期淨利(淨損)       | 2,056         | 2,639         | 3,974         |
| 稀釋每股盈餘(元)      | 0.31          | 0.40          | 0.58          |

### 半導體封裝測試營運

| 產 品 結 構    | 占營收比率(%) |
|------------|----------|
| 通訊產品       | 51       |
| 個人電腦       | 11       |
| 汽車及消費性電子產品 | 37       |
| 其他         | 1        |
| 前十大客戶佔營收比重 | 50       |

| 銷 售 地 區 | 占營收比率(%) |
|---------|----------|
| 北美      | 58       |
| 歐洲      | 11       |
| 台灣      | 19       |
| 日本      | 5        |
| 亞洲其他地區  | 7        |

| 封 裝 業 務 產 品 組 合                      | 占營收比率(%) |
|--------------------------------------|----------|
| Advanced substrate & leadframe based | 80       |
| Traditional leadframe based          | 10       |
| Module assembly                      | 6        |
| Others                               | 4        |
| 封裝資本支出金額                             | 106 百萬美元 |
| 打線機台數                                | 13,911 台 |

| 測 試 業 務 產 品 組 合 | 占營收比率(%) |
|-----------------|----------|
| 後段測試            | 82       |
| 晶圓測試            | 16       |
| 前段測試            | 2        |
| 測試資本支出金額        | 39 百萬美元  |
| 測試機台數           | 2,628 台  |

### 電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

| 產 品 結 構    | 占營收比率(%) |
|------------|----------|
| 通訊產品       | 39       |
| 電腦產品       | 22       |
| 消費產品       | 14       |
| 工業產品       | 15       |
| 汽車電子產品     | 10       |
| 其他         | 0        |
| 前十大客戶佔營收比重 | 82       |
| EMS 資本支出金額 | 9 百萬美元   |